



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 107124491 A

(43)申请公布日 2017.09.01

(21)申请号 201710456896.8

(22)申请日 2017.06.15

(71)申请人 广东欧珀移动通信有限公司
地址 523860 广东省东莞市长安镇乌沙海
滨路18号

(72)发明人 曾元清

(74)专利代理机构 深圳翼盛智成知识产权事务
所(普通合伙) 44300

代理人 黄威

(51) Int. Cl.

H04M 1/02(2006.01)

H04M 1/18(2006.01)

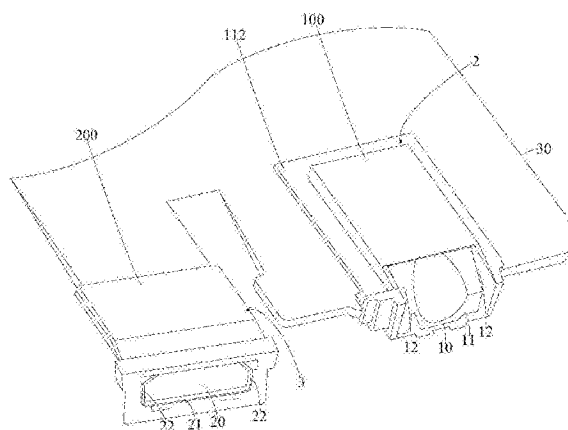
权利要求书1页 说明书8页 附图8页

(54)发明名称

保护套、基座组件和电子设备

(57)摘要

本发明公开了一种保护套、基座组件和电子设备。其中保护套包括第一贴合部、第二贴合部及连接部，第一贴合部和第二贴合部共同包覆基座的外表面，第一贴合部、第二贴合部和连接部一体成型，连接部设置于第一贴合部和第二贴合部之间，第一贴合部和第二贴合部可通过连接部发生弹性形变以将保护套套设于基座上。第一贴合部、第二贴合部以及连接部三者一体成型，从而防止第一贴合部和连接部之间形成缝隙，以及防止第二贴合部和连接部之间形成缝隙，提升基座防水性能。



1. 一种保护套,用于套设于基座上,其特征在于:所述保护套包括第一贴合部、第二贴合部及连接部,所述第一贴合部和所述第二贴合部共同包覆所述基座的外表面,所述第一贴合部、所述第二贴合部和所述连接部一体成型,所述连接部设置于所述第一贴合部和所述第二贴合部之间,所述第一贴合部和所述第二贴合部可通过所述连接部发生弹性形变以将所述保护套套设于所述基座上。

2. 根据权利要求1所述的保护套,其特征在于,所述第一贴合部设置有放置所述基座的第一收纳腔,所述第二贴合部设置有放置所述基座的第二收纳腔,当所述基座放置到所述第一收纳腔和第二收纳腔内时,所述第一收纳腔和所述第二收纳腔分别与所述基座紧贴。

3. 根据权利要求2所述的保护套,其特征在于,所述连接部设置有避让所述基座的避让孔,当所述保护套套设于所述基座上时,所述连接部与所述基座的端部贴合,对所述基座的端部紧贴。

4. 根据权利要求3所述的保护套,其特征在于,所述避让孔从所述连接部延伸至所述第一贴合部,所述避让孔部分位于所述第一贴合部位置。

5. 根据权利要求2所述的保护套,其特征在于,所述第一贴合部边沿设置有第一凸边,所述第一凸边位于所述第一收纳腔的边沿;所述第二贴合部设置有第二凸边,所述第二凸边位于所述第二收纳腔的边沿。

6. 根据权利要求5所述的保护套,其特征在于,所述第一凸边和所述第一收纳腔的侧壁垂直,所述第二凸边和所述第二收纳腔的侧壁垂直。

7. 根据权利要求1所述的保护套,其特征在于,所述第一贴合部包括有缓冲部,所述缓冲部位于所述第一贴合部和所述连接部的连接位置,所述缓冲部的厚度从所述连接部至所述第一贴合部方向逐渐增加。

8. 根据权利要求1所述的保护套,其特征在于,所述连接部设置有加强片。

9. 根据权利要求8所述的保护套,其特征在于,所述加强片位于所述第一贴合部和所述连接部的连接边沿处,且凸出于所述连接部和所述第一贴合部表面。

10. 根据权利要求9所述的保护套,其特征在于,所述加强片包括第一加强部、第二加强部和第三加强部,所述第一加强部和所述第二加强部分别位于所述连接部的两侧,所述第一加强部和所述第二加强部对称,所述第三加强部位于所述连接部的一端。

11. 根据权利要求8所述的保护套,其特征在于,所述加强片位于所述连接部的两侧。

12. 根据权利要求11所述的保护套,其特征在于,所述加强片包括有至少两个台阶,所述台阶的个数从所述连接部位置向外逐渐减少。

13. 根据权利要求1至12任一项所述的保护套,其特征在于,所述保护套采用硅胶或泡棉制成。

14. 一种基座组件,其特征在于,所述基座组件包括:基座和如权利要求1至13任一项所述的保护套,所述保护套套设于所述基座上。

15. 一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括如权利要求14所述的基座组件。

保护套、基座组件和电子设备

技术领域

[0001] 本发明涉及电子设备技术领域,具体涉及一种保护套、基座组件和电子设备。

背景技术

[0002] 现有技术中耳机座或接口座等基座可以设置在电子设备内,比如可以集成在电子设备的电路板上,电子设备设置有供耳机和耳机座插接的通孔。随着用户对电子设备的使用,用户对电子设备的防水性能要求越来越高,而现有技术中对基座的防水设计中,往往是通过两个防水片相互叠加,实现对基座的防水。

[0003] 然而,在实际生产过程中,两个防水片相互叠加容易形成缝隙,导致密封不严实,容易漏水。另外,在长时间的使用过程中,两个防水片相互叠加容易产生缝隙,容易漏水。

发明内容

[0004] 本发明实施例提供一种保护套、基座组件和电子设备,可以提升基座的防水性能。

[0005] 第一方面,本发明实施例提供一种保护套,用于套设于基座上,所述保护套包括第一贴合部、第二贴合部及连接部,所述第一贴合部和所述第二贴合部共同包覆所述基座的外表面,所述第一贴合部、所述第二贴合部和所述连接部一体成型,所述连接部设置于所述第一贴合部和所述第二贴合部之间,所述第一贴合部和所述第二贴合部可通过所述连接部发生弹性形变以将所述保护套套设于所述基座上。

[0006] 第二方面,本发明实施例提供了一种基座组件,所述基座组件包括基座和如上所述的保护套,所述保护套套设在所述基座上。

[0007] 第三方面,本发明实施例提供了一种电子设备,所述电子设备包括如上所述的基座组件。

[0008] 本发明实施例,提供的保护套中第一贴合部、第二贴合部以及连接部三者一体成型,防止第一贴合部和连接部之间形成缝隙,以及防止第二贴合部和连接部之间形成缝隙,进而防止保护套漏水,实现对基座的保护、密封和防水,提升基座的防水性能。

附图说明

[0009] 为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0010] 图1为本发明实施例提供的电子设备的结构示意图。

[0011] 图2为图1所示电子设备的分解示意图。

[0012] 图3为图2所示印制电路板中A的局部放大图。

[0013] 图4为图2所示印制电路板中B的局部放大图。

[0014] 图5为本发明实施例提供的基座组件的结构示意图。

- [0015] 图6为本发明实施例提供的保护套的结构示意图。
- [0016] 图7为图6所示保护套的另一视角示意图。
- [0017] 图8为本发明实施例提供的基座组件的另一结构示意图。
- [0018] 图9为本发明实施例提供的保护套的另一结构示意图。
- [0019] 图10为图9所示保护套的另一视角示意图。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0021] 在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

[0022] 在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接或可以相互通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0023] 在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

[0024] 下文的公开提供了许多不同的实施方式或例子用来实现本发明的不同结构。为了简化本发明的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。当然,它们仅仅为示例,并且目的不在于限制本发明。此外,本发明可以在不同例子中重复参考数字和/或参考字母,这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施方式和/或设置之间的关系。此外,本发明提供了的各种特定的工艺和材料的例子,但是本领域普通技术人员可以意识到其他工艺的应用和/或其他材料的使用。

[0025] 本发明实施例提供了一种保护套、基座组件及电子设备。以下将分别进行详细说明。

[0026] 在本实施例中,将从基座组件的角度进行描述,该基座组件具体可以集成在电子

设备中,比如手机、平板电脑、掌上电脑(PDA,Personal Digital Assistant)等。

[0027] 请参阅1和图2,电子设备1包括盖板60、显示屏70、印制电路板30、电池40、后盖50。

[0028] 其中,盖板60安装到显示屏70上,以覆盖显示屏70。盖板60可以为透明玻璃盖板。在一些实施方式中,盖板60可以用诸如蓝宝石等材料制成的玻璃盖板。该盖板60包括显示区域61和非显示区域62。该显示区域61可以用来显示终端的画面或者供用户进行触摸操控等。该非显示区域62的顶部区域开设供声音、及光线传导的开孔,该非显示区域62底部上可以设置指纹模组、触控按键等功能组件。

[0029] 该显示屏70贴合安装在该盖板60之下。以形成电子设备1的显示面。

[0030] 印制电路板30安装在后盖50内部。印制电路板30可以为电子设备1的主板。印制电路板30上可以集成有基座组件、天线、马达、麦克风、摄像头、光线传感器、受话器以及处理器等功能组件。同时,显示屏70电连接至印制电路板30上。

[0031] 该电池40安装在后盖50中,与该印制电路板30进行电连接,以向电子终端1提供电源。

[0032] 该后盖50与盖板60可以组合形成一壳体,该壳体具有通过后盖50与盖板60形成密闭的空间。

[0033] 请参阅图3,图3为图2中印制电路板的A的局部放大图,该基座组件(2、3)包括有基座(10、20)和套设在基座(10、20)上的保护套(100、200),保护套(100、200)对基座(10、20)进行保护,提升防水性能。其中,基座(10、20)可以集成在电子设备1的印制电路板30上,该基座(10、20)可以是耳机座10,也可以是接口座20,比如USB接口座,下面基座以耳机座10为例对基座组件2进行详细说明。

[0034] 请一并参阅图4和图5,图4为图2中印制电路板的B的局部放大图,图5为本发明实施例提供的基座组件的结构示意图,基座组件2包括基座10和保护套100,基座10被包覆于保护套100内。其中,基座10包括有一侧部12、两个端部11,需要说明的是,图4和图5中仅示出了基座10的其中一个端部11,而基座10的另一个端部被遮挡住,未显示出。具体的,基座10的侧部12位于基座10的两个端部11之间,侧部12可以为一圆筒结构,也可以具有多个面。基座10的一个端部11可以与其它器件连接,比如,基座10的一个端部11与耳机、音箱等插接;基座10的另一个端部可以直接集成在印制电路板30上。

[0035] 请一并参阅图6和图7,图6和图7为本发明实施例提供的保护套的结构示意图,在一些实施例中,本发明实施例的保护套100包括第一贴合部110、第二贴合部120及连接部130,第一贴合部110和第二贴合部120共同包覆基座10的外表面,第一贴合部110、第二贴合部120和连接部130一体成型,连接部130设置于第一贴合部110和第二贴合部120之间,第一贴合部110和第二贴合部120可通过连接部130发生弹性形变以将保护套100套设于基座10上。

[0036] 在一些实施例中,第一贴合部110、第二贴合部120及连接部130可以发生弹性形变,以便将基座10放置于第一贴合部110、第二贴合部120及连接部130之间,进而便于第一贴合部110、第二贴合部120及连接部130将基座10包覆。保护套100可以采用软质材料制成,以实现弹性形变,比如保护套100采用硅胶制成,硅胶弹性好、防水效果好,且成本低。需要说明的是,保护套100的材料并不限于硅胶,还可以采用其它材料,比如保护套100采用泡棉制成。

[0037] 在实现保护套100的弹性形变过程中,具体的,可以在第一贴合部110和连接部130的连接位置进行折弯,使得第一贴合部110和连接部130产生弹性形变;也可以在第二贴合部120和连接部130的连接位置进行折弯,使得第二贴合部120和连接部130产生弹性形变;还可以仅在连接部130的中部位置进行折弯,使得连接部130产生弹性形变。需要说明的是,使得保护套100产生弹性形变的方式并不限于此,比如:仅将第一贴合部110、第二贴合部120及连接部130三者中的一个折弯,仅一个产生形变;或者同时将第一贴合部110、第二贴合部120及连接部130三者同时折弯,使得第一贴合部110、第二贴合部120及连接部130三者都产生弹性形变。

[0038] 在一些实施例中,为了便于实现折弯,第一贴合部110包括有缓冲部113,缓冲部113位于第一贴合部110和连接部130的连接位置,缓冲部113的厚度从连接部130至第一贴合部110方向逐渐增加。从而,第一贴合部110和连接部130的连接位置处的缓冲部113的厚度较薄,容易产生折弯,进而产生弹性形变。在实际操作过程中,第一贴合部110在缓冲部113位置进行折弯,折弯过程中主要在缓冲部113位置产生弹性形变,而连接部130仅产生较小的弹性形变,或不产生形变,在折弯过程中仅第一贴合部110的缓冲部113产生形变,对其它位置产生的影响较小。需要说明的是,也可以在第二贴合部120和连接部130的连接位置设置缓冲部,以便第二贴合部120折弯。

[0039] 在一些实施例中,第一贴合部110可以包覆在基座10的上部,并贴合于基座10的上部,第二贴合部120可以包覆在基座10的下部,并贴合于基座10的下部。需要说明的是,第一贴合部110和第二贴合部120在分别包覆基座10的上部和下部时,第一贴合部110和第二贴合部120在上部和下部的之间可以相互贴合实现密封,也可以形成空隙,以便与其它部件配合,比如印制电路板30。

[0040] 第一贴合部110和第二贴合部120包裹于基座10的周围,对基座10的周围紧贴。也就是说,第一贴合部110和第二贴合部120将基座10的侧部12包裹、紧贴,以实现对接座10的侧部12的密封、防水。具体的,第一贴合部110设置有用于放置基座10的第一收纳腔111,第二贴合部120设置有放置基座10的第二收纳腔121,当基座10的放置到第一收纳腔111和第二收纳腔121内时,第一收纳腔111和第二收纳腔121分别与基座10的侧部12紧贴。

[0041] 需要说明的是,图6和图7中仅示出了第一收纳腔111和第二收纳腔121的外部结构,而未示出第一收纳腔111和第二收纳腔121的内部槽形结构。在一些实施例中,第一收纳腔111和第二收纳腔121的内部结构和基座10的表面相适配,实现对基座10表面的紧贴。

[0042] 还需要说明的是,设置第一收纳腔和第二收纳腔用于收纳基座是本发明实施例的一种方式,本发明实施例并不限于此,比如仅设置第一收纳腔或仅设置第二收纳腔。再比如,不设置收纳腔,而将第一贴合部、第二贴合部设置成平缓的结构,由于第一贴合部和第二贴合采用软质材料制成,从而,在实际配合过程中,可以根据实际需要第一贴合部和第二贴合控制,使得产生相应的形变。

[0043] 在一些实施例中,第一贴合部110边沿设置有第一凸边112,第一凸边112位于第一收纳腔111的边沿,第二贴合部120设置有第二凸边122,第二凸边122位于第二收纳腔121的边沿。具体的,第一凸边112和第一收纳腔111的侧壁之间相互垂直,第二凸边122和第二收纳腔121的侧壁之间相互垂直。当保护套100套设于基座10上时,且基座10集成在印制电路板30上时,第一凸边112和第二凸边122可以贴合于印制电路板30上。需要说明的是,第

一凸边112和第二凸边122也可以贴合于其它位置。

[0044] 在一些实施例中,连接部130连接于第一贴合部110和第二贴合部120之间,且位于第一贴合部110和第二贴合部120的一端端部,第一贴合部110、第二贴合部120可通过连接部130折弯,从而可以通过第一贴合部110、第二贴合部120分别与连接部130的折弯活动,将基座10放置于第一贴合部110、第二贴合部120以及连接部130之间,再通过第一贴合部110和第二贴合部120对连接部130的折弯活动紧扣,不仅使得第一贴合部110、第二贴合部120与基座10的侧部12周围紧贴,而且使得连接部130对基座10的端部11紧贴,实现对基座10的紧贴、密封,提升防水性能。

[0045] 在一些实施例中,第一贴合部110、第二贴合部120和连接部130一体成型,当保护套100套设于基座10上时,连接部130与基座10的端部11贴合,对基座10的端部11紧贴。从而防止第一贴合部110和连接部130之间形成缝隙,以及防止第二贴合部120和连接部130之间形成缝隙,进而防止保护套100漏水,实现对基座10的密封、防水,提升基座10的防水性能。

[0046] 在一些实施例中,连接部130设置有用于避让基座10的避让孔131,以便耳机或音箱等的插头插接到基座10内。需要说明的是,避让孔131可以仅位于连接部130的位置,也可以从连接部130延伸至第一贴合部110或第二贴合部120。具体的,比如:避让孔131从连接部130延伸至第一贴合部110,避让孔131部分位于第一贴合部110位置,第一贴合部110在避让孔131延伸的部分形成有以上的缓冲部113,将缓冲部113具体形成在避让孔131的位置处,进一步方便折弯,产生弹性形变。

[0047] 在一些实施例中,连接部130设置有加强片132,加强片132位于连接部130的两侧,且位于第一贴合部110和第二贴合部120连接位置,不仅增加连接部130的强度,而且增加第一贴合部110和第二贴合部120连接位置的强度,防止因折弯而损坏。

[0048] 具体的,加强片132包括有至少两个台阶133,台阶133的个数从连接部130位置向外逐渐减少,也就是说加强片整体的厚度从外部至连接部130的位置逐渐增加。从而在折弯连接部130的过程中,加强片132对连接部130起到保护作用,防止因折弯而损坏。

[0049] 需要说明的是,加强片132的结构、位置并不限于此,比如:加强片位于第一贴合部和连接部的连接边沿处,且凸出于连接部和第一贴合部表面;具体的,加强片包括第一加强部、第二加强部和第三加强部,第一加强部和第二加强部分别位于连接部的两侧,第一加强部和第二加强部对称,第三加强部位位于连接部的一端。从而在折弯第一贴合部和连接部的过程中,加强片对第一贴合部和连接部共同进行保护,防止因折弯而损坏。当然,还可以将加强片设置在第二贴合部和连接部之间,或在第一贴合部、第二贴合部及连接部三者的连接位置设置加强片。

[0050] 下面基座以接口座20为例对基座组件3进行详细说明,需要说明的是,接口座可以为USB接口座或其它接口座。

[0051] 请参阅图8,图8为本发明实施例提供的另一基座组件的结构示意图,基座组件3包括基座20和保护套200,基座20被包覆于保护套200内。其中,基座20包括有一侧部22、两个端部21,需要说明的是,图8中仅示出了基座20的其中一个端部21,而基座20的另一个端部被遮挡住,未显示出。具体的,基座20的侧部22位于基座20的两个端部21之间,侧部22可以为一圆筒结构,也可以具有多个面。基座20的一个端部21可以与其它器件连接,比如,基座20的一个端部21与USB接口等插接;基座10的另一个端部可以直接集成在印制电路板30上。

[0052] 请一并参阅图9和图10,图9和图10为本发明实施例提供的保护套的另一结构示意图,在一些实施例中,本发明实施例的保护套200包括第一贴合部210、第二贴合部220及连接部230,第一贴合部210和第二贴合部220共同包覆基座20的外表面,第一贴合部210、第二贴合部220和连接部230一体成型,连接部230设置于第一贴合部210和第二贴合部220之间,第一贴合部210和第二贴合部220可通过连接部230发生弹性形变以将保护套200套设于基座20上。

[0053] 在一些实施例中,第一贴合部210、第二贴合部220及连接部230可以发生弹性形变,以便将基座20放置于第一贴合部210、第二贴合部220及连接部230之间,进而便于第一贴合部210、第二贴合部220及连接部230将基座20包覆。保护套200可以采用软质材料制成,以实现弹性形变,比如保护套200采用硅胶制成,硅胶弹性好、防水效果好,且成本低。需要说明的是,保护套100的材料并不限于硅胶,还可以采用其它材料,比如保护套200采用泡棉制成。

[0054] 在实现保护套200的弹性形变过程中,具体的,可以在第一贴合部210和连接部230的连接位置进行折弯,使得第一贴合部210和连接部230产生弹性形变;也可以在第二贴合部220和连接部230的连接位置进行折弯,使得第二贴合部220和连接部230产生弹性形变;还可以仅在连接部230的中部位置进行折弯,使得连接部230产生弹性形变。需要说明的是,使得保护套200产生弹性形变的方式并不限于此,比如:仅将第一贴合部210、第二贴合部220及连接部230三者中的一个折弯,仅一个产生形变;或者同时将第一贴合部210、第二贴合部220及连接部230三者同时折弯,使得第一贴合部210、第二贴合部220及连接部230三者都产生弹性形变。

[0055] 在一些实施例中,为了便于实现折弯,第一贴合部210包括有缓冲部212,缓冲部212位于第一贴合部210和连接部230的连接位置,缓冲部212的厚度从连接部230至第一贴合部210方向逐渐增加。从而,第一贴合部210和连接部230的连接位置处的缓冲部212的厚度较薄,容易产生折弯,进而产生弹性形变。在实际操作过程中,第一贴合部210在缓冲部212位置进行折弯,折弯过程中主要在缓冲部212位置产生弹性形变,而连接部230仅产生较小的弹性形变,或不产生形变,在折弯过程中仅第一贴合部210的缓冲部212产生形变,对其它位置产生的影响较小。需要说明的是,也可以在第二贴合部220和连接部230的连接位置设置缓冲部,以便第二贴合部220折弯。

[0056] 在一些实施例中,第一贴合部210可以包覆在基座20的上部,并贴合于基座20的上部,第二贴合部220可以包覆在基座20的下部,并贴合于基座20的下部。需要说明的是,第一贴合部210和第二贴合部220在分别包覆基座20的上部和下部时,第一贴合部210和第二贴合部220在上部和下部的之间可以相互贴合实现密封,也可以形成空隙,以便与其它部件配合,比如印制电路板30。

[0057] 在一些实施例中,第一贴合部210和第二贴合部220包裹于基座20的周围,对基座20的周围紧贴。也就是说,第一贴合部210和第二贴合部220将基座20的侧部22包裹、紧贴,以实现基座20的侧部22的密封、防水。具体的,第一贴合部210设置有用于放置基座20的第一收纳腔211,第二贴合部220设置有放置基座20的第二收纳腔221,当基座20的放置到第一收纳腔211和第二收纳腔221内时,第一收纳腔211和第二收纳腔221分别与基座20的侧部22紧贴。

[0058] 需要说明的是,图9和图10中仅示出了第一收纳腔211和第二收纳腔221的外部结构,而未示出第一收纳腔211和第二收纳腔221的内部槽形结构。在一些实施例中,第一收纳腔211和第二收纳腔221的内部结构和基座20的侧部22相适配,实现对基座20侧部22的紧贴。

[0059] 还需要说明的是,设置第一收纳腔和第二收纳腔用于收纳基座是本发明实施例的一种方式,本发明实施例并不限于此,比如仅设置第一收纳腔或仅设置第二收纳腔。再比如,不设置收纳腔,而将第一贴合部、第二贴合部设置成平缓的结构,由于第一贴合部和第二贴合采用软质材料制成,从而,在实际配合过程中,可以根据实际需要第一贴合部和第二贴合控制,使得产生相应的形变。

[0060] 在一些实施例中,第一贴合部210边沿也可以设置有第一凸边,第一凸边位于第一收纳腔211的边沿,第二贴合部220也可以设置有第二凸边,第二凸边位于第二耳机收纳腔221的边沿。具体的,第一凸边和第一收纳腔211的侧壁之间相互垂直,第二凸边和第二收纳腔221的侧壁之间相互垂直。当保护套200套设于基座20上时,且基座20集成在电路板30上时,第一凸边和第二凸边可以贴合于印制电路板30上。需要说明的是,第一凸边和第二凸边也可以贴合于其它位置。

[0061] 在一些实施例中,连接部230连接于第一贴合部210和第二贴合部220之间,且位于第一贴合部210和第二贴合部220的一端端部,第一贴合部210和第二贴合部220可通过连接部230折弯,从而可以通过第一贴合部210、第二贴合部220分别与连接部230的折弯活动,将基座20放置于第一贴合部210、第二贴合部220以及连接部230之间,再通过第一贴合部210和第二贴合部220对连接部230的折弯活动紧扣,不仅使得第一贴合部210、第二贴合部220与基座20的侧部22周围紧贴,而且使得连接部230对基座20的端部21紧贴,实现对基座20的紧贴、密封,提升防水性能。

[0062] 在一些实施例中,第一贴合部210、第二贴合部220和连接部230一体成型,当保护套200套设于基座20上时,连接部230与基座20的端部贴合,对基座20的端部紧贴。从而防止第一贴合部210和连接部230之间形成缝隙,以及防止第二贴合部220和连接部230之间形成缝隙,进而防止保护套200漏水,实现对基座20的密封、防水,提升防水性能。

[0063] 在一些实施例中,连接部230设置有用以避让基座20的避让孔231,以便接口线等的插头插接到基座20内。需要说明的是,避让孔231可以仅位于连接部230的位置,也可以从连接部230延伸至第一贴合部210或第二贴合部220。具体的,比如:避让孔231从连接部230延伸至第一贴合部210,避让孔231部分位于第一贴合部210位置,第一贴合部210在避让孔231延伸的部分形成有以上的缓冲部212,将缓冲部212具体形成在避让孔231的位置处,进一步方便折弯,产生弹性形变。

[0064] 在一些实施例中,连接部230设置有加强片232,加强片232位于第一贴合部210和连接部230的连接边沿处,且凸出于连接部230和第一贴合部210表面;具体的,加强片232包括第一加强部2321、第二加强部2322和第三加强部2323,第一加强部2321和第二加强部2322分别位于连接部230的两侧,第一加强部2321和第二加强部2322对称,第三加强部2323位于连接部230的一端。从而在折弯第一贴合部210和连接部230的过程中,加强片232对第一贴合部210和连接部230共同进行保护,防止因折弯而损坏。当然,也可以将加强片设置在第二贴合部和连接部之间,或在第一贴合部、第二贴合部及连接部三者的连接位置设置加

强片。

[0065] 需要说明的是,加强片132的结构、位置并不限于此,比如:加强片位于连接部的两侧,且位于第一贴合部和第二贴合部连接位置,不仅增加连接部的强度,而且增加第一贴合部和第二贴合部连接位置的强度,防止因折弯而损坏。具体的,加强片包括有至少两个台阶,台阶的个数从连接部位置向外逐渐减少,也就是说加强片整体的厚度从外部至连接部的位置逐渐增加。从而在折弯连接部的过程中,加强片对连接部起到保护作用,防止因折弯而损坏。

[0066] 本领域技术人员可以理解,图1和图2中示出的电子设备1的结构并不构成对电子设备1的限定。电子设备1可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。电子设备1还可以包括处理器、存储器、蓝牙模块等,在此不再赘述。

[0067] 以上对本发明实施例提供的保护套、基座组件及电子设备进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明。同时,对于本领域的技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

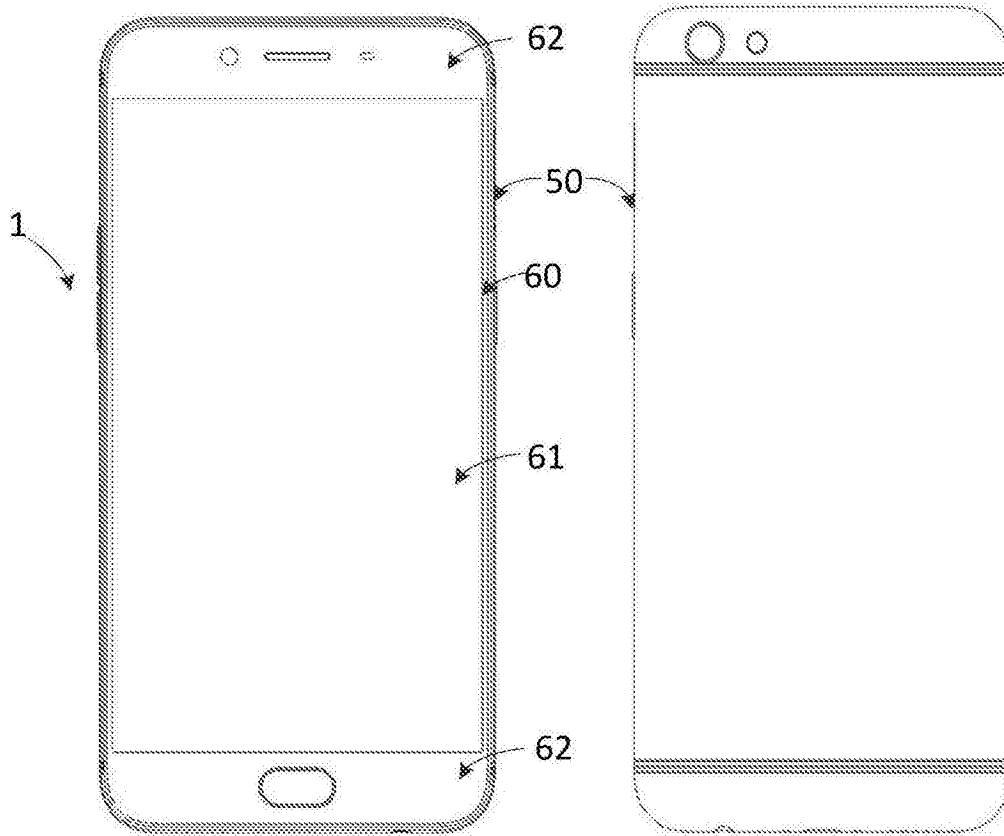


图1

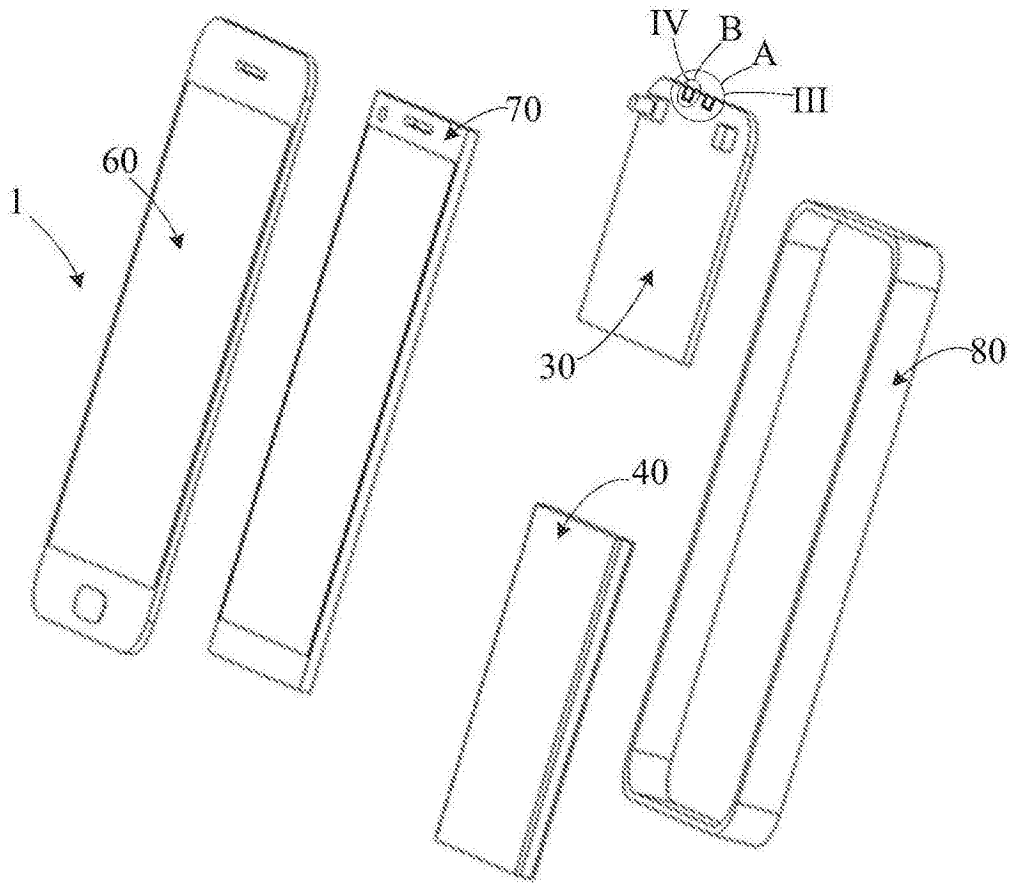


图2

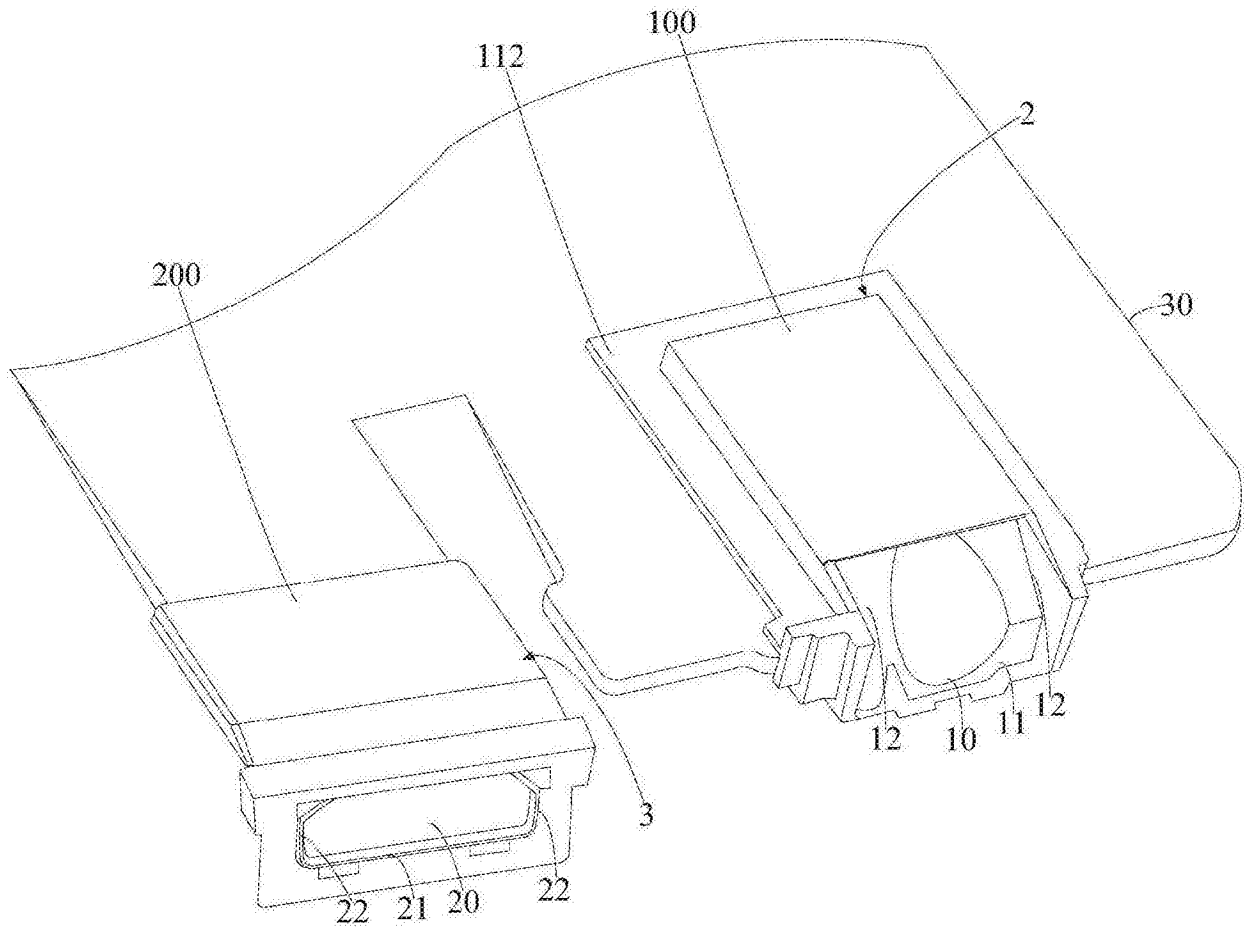


图3

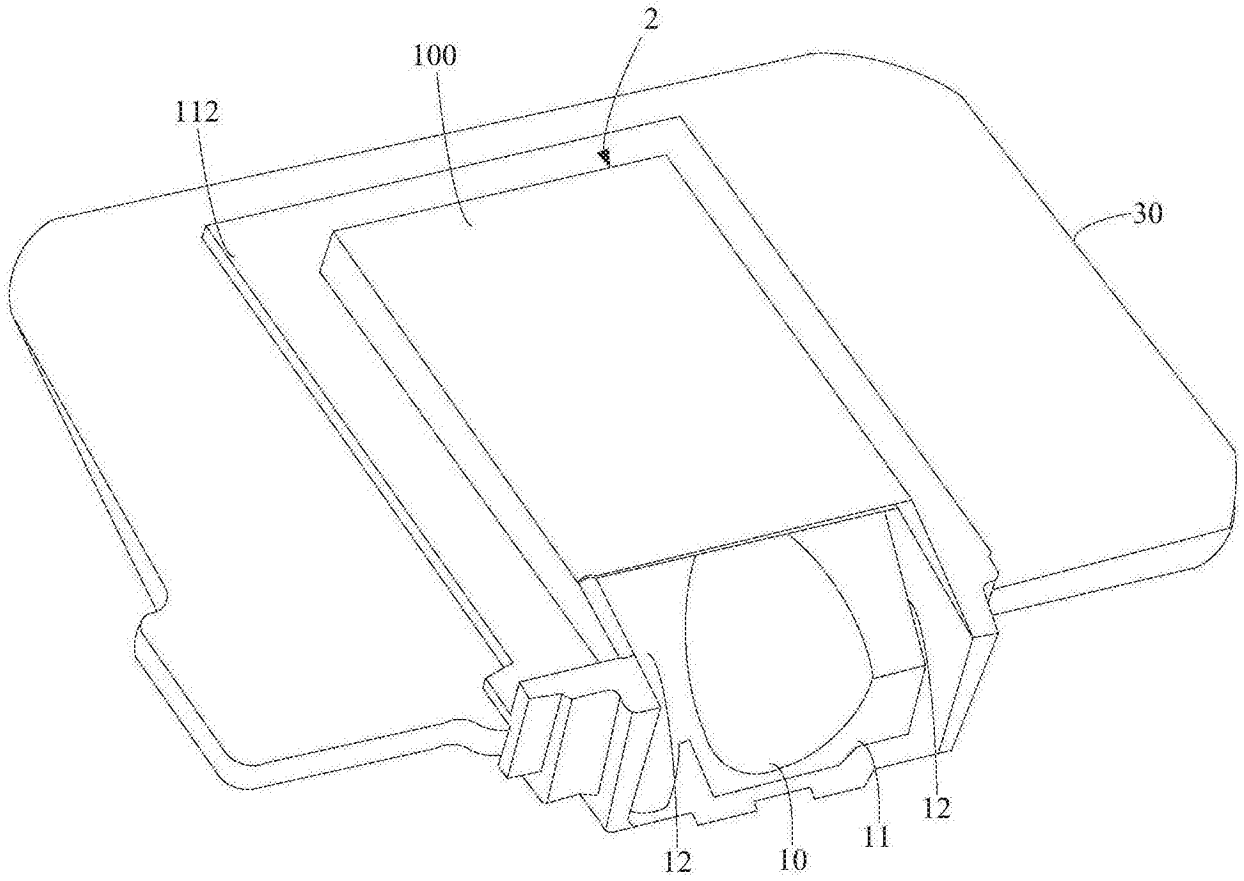


图4

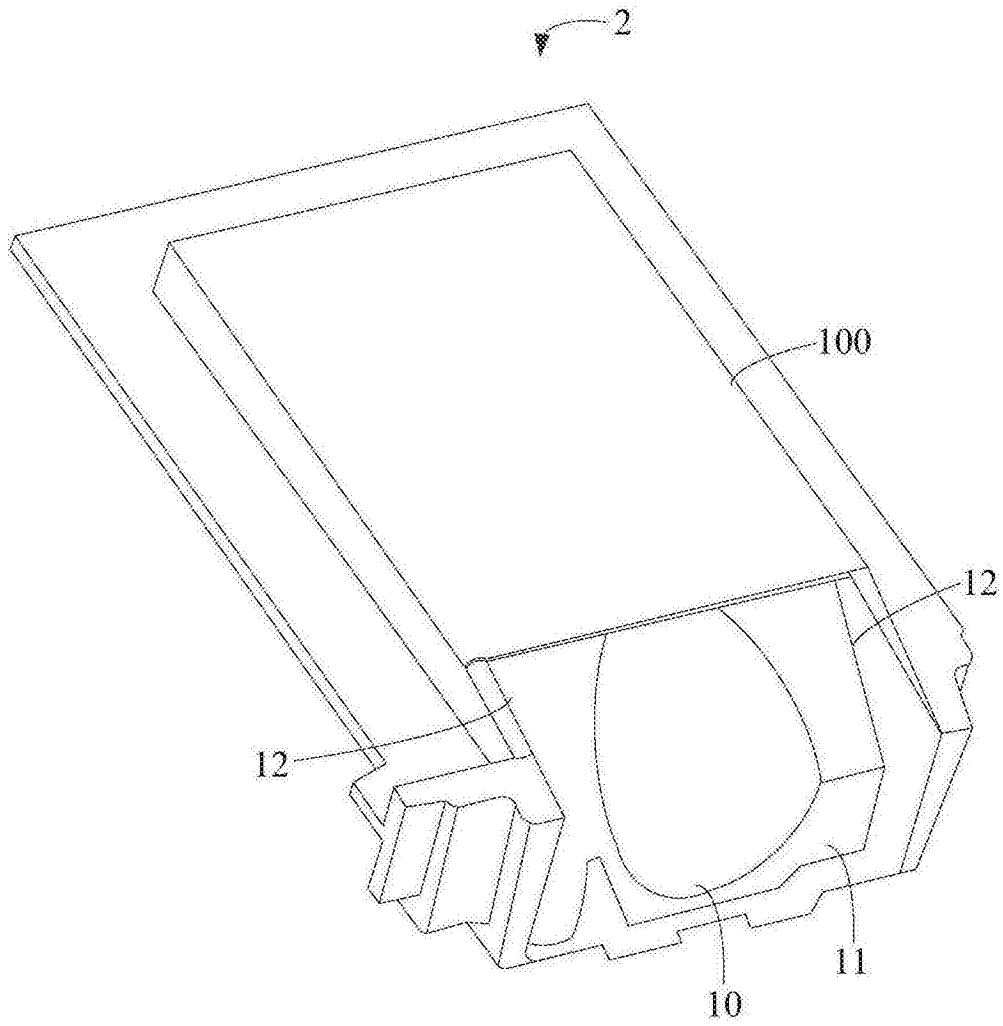


图5

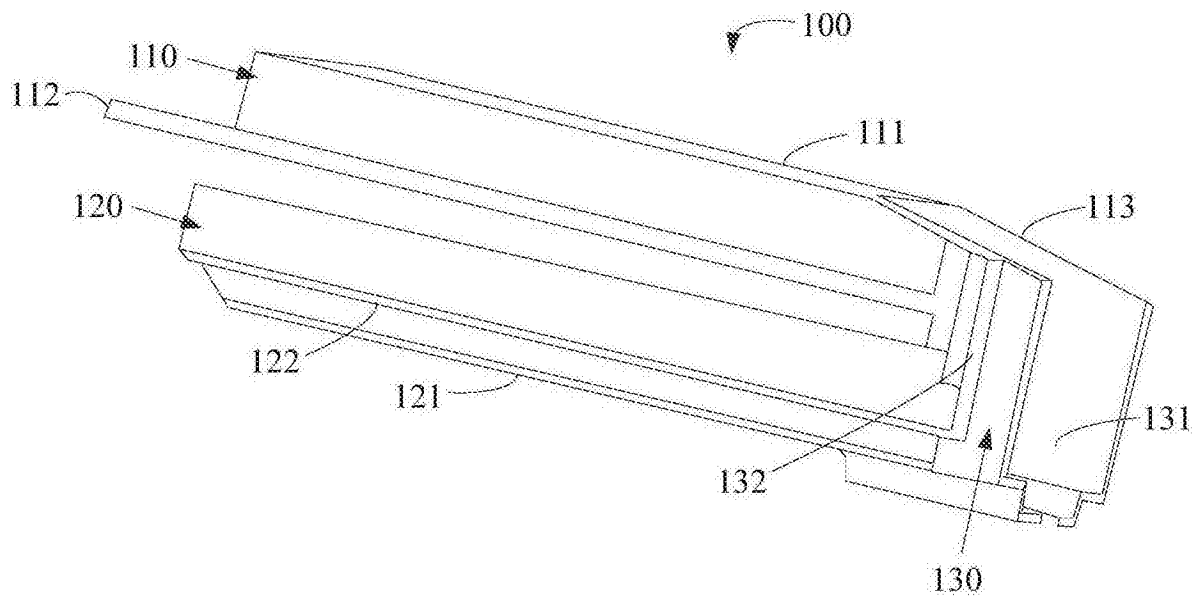


图6

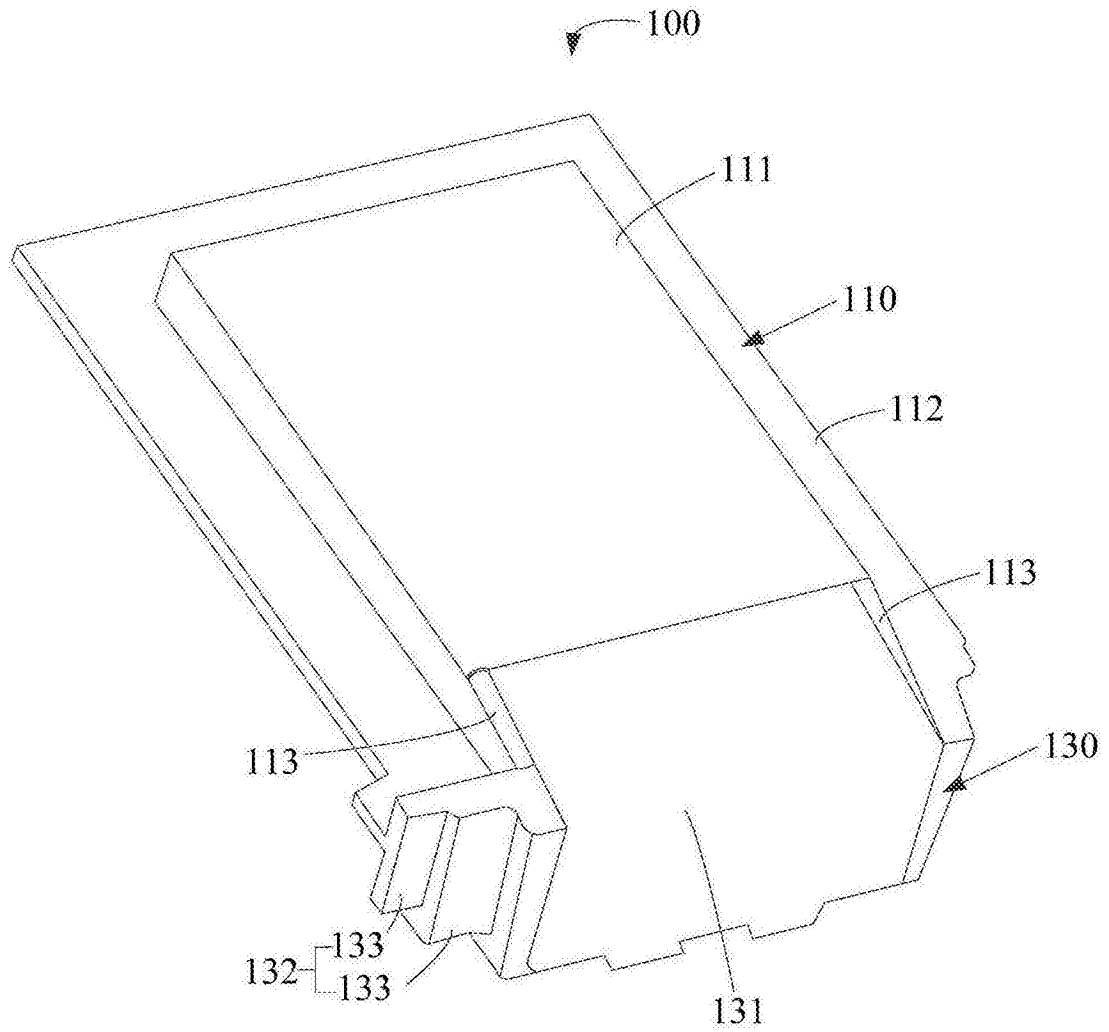


图7

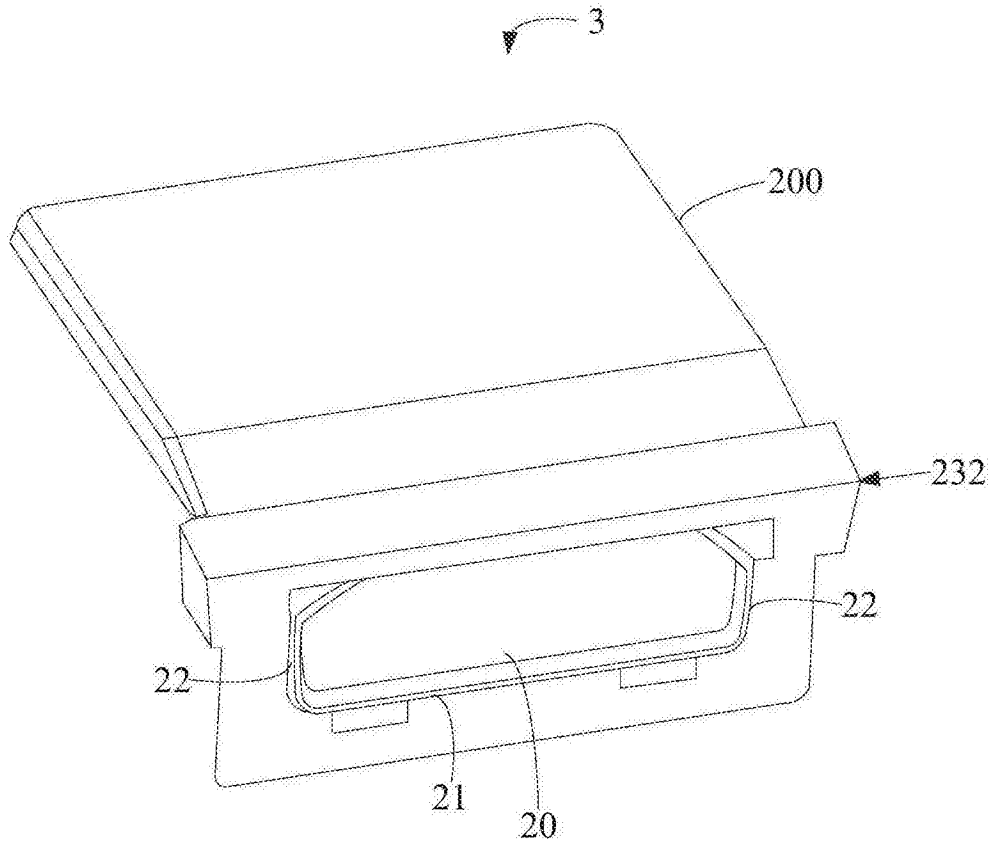


图8

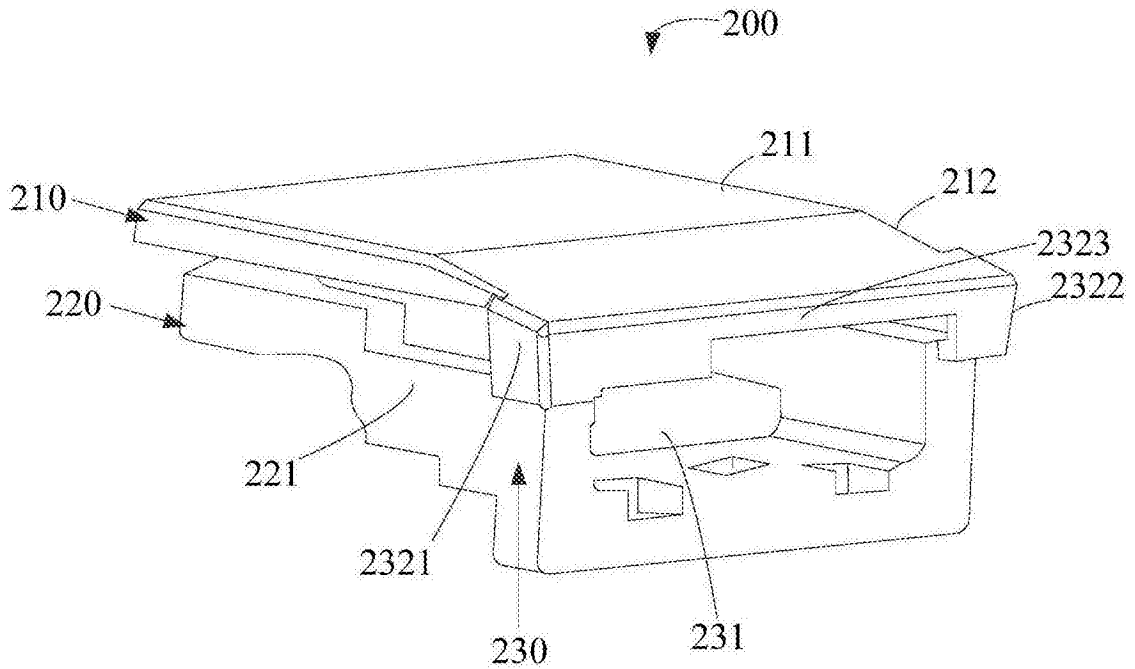


图9

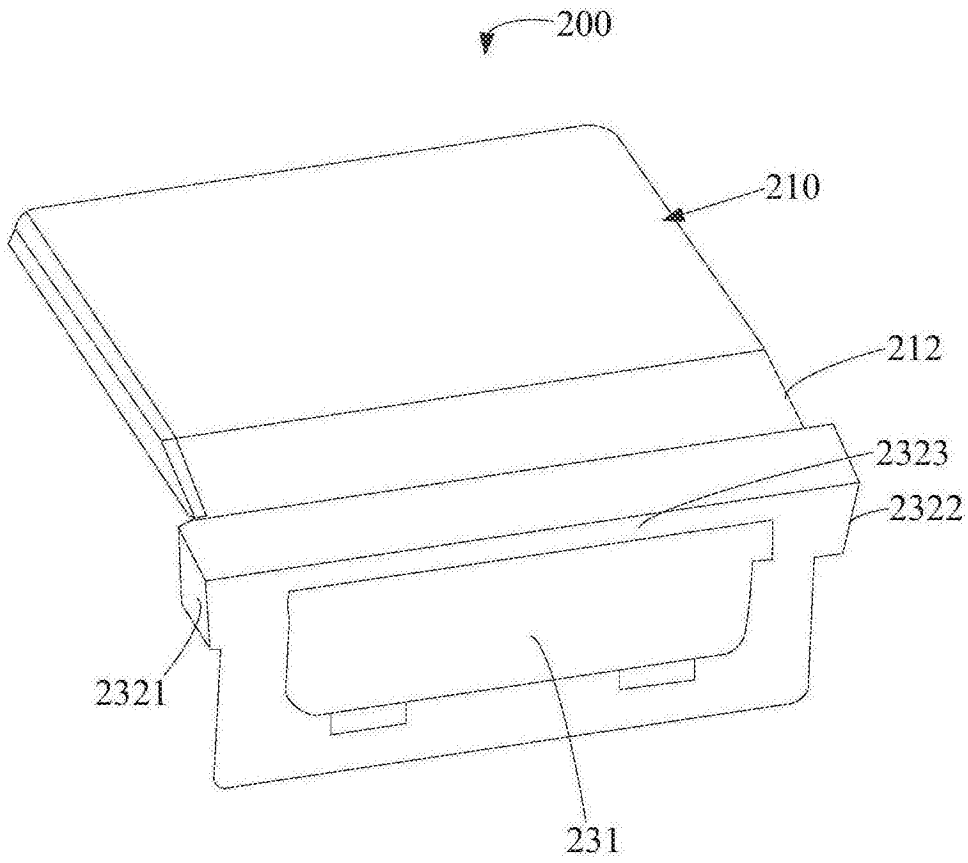


图10